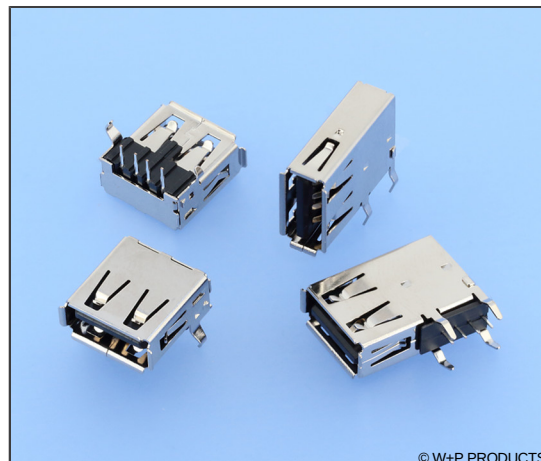
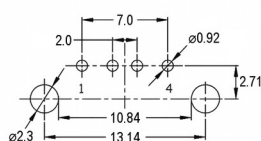
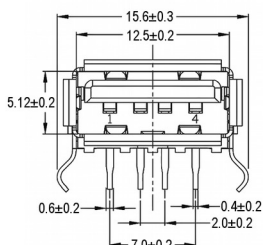
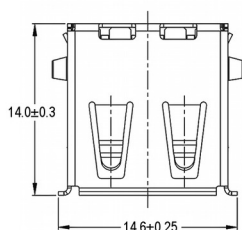


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse <i>Shell</i>	Messing, vernickelt <i>Nickel plated brass</i>
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel (siehe Optionen unten) <i>Gold over nickel (see options below)</i>
Oberfläche Lötanschluss <i>Plating Solder Side</i>	Zinn über Nickel <i>Tin plated over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	30 V RMS
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1,5 A bei 25°C <i>1,5 A at 25°C</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +85 °C -25 °C ... +85 °C (Model 3) -55 °C ... +85 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>

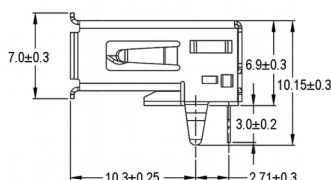


© W+P PRODUCTS



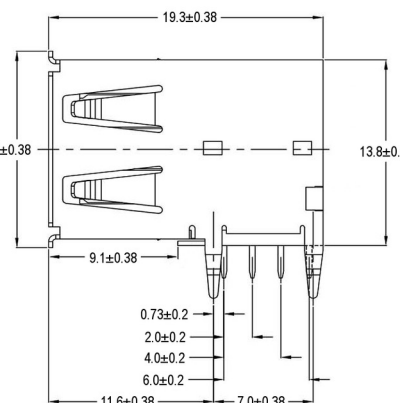
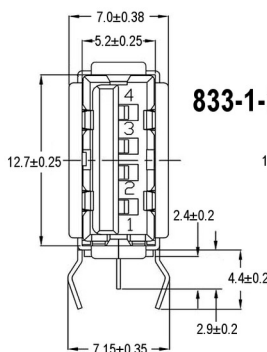
PCB Layout

833-1-2



PCB Layout

833-1-3



Series	Type	Model*	Colour*	Plating*
833	1	2	30	80
	1 Type A (female)	2 Gewinkelt horizontal Horizontal, right-angled 3 Gewinkelt vertikal Vertical, right-angled	10 Schwarz Black 30 Weiß White	60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

